

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 102, DE 16 DE ABRIL DE 2015

Altera o Processo Produtivo Básico para os produtos TELEJOGOS E SEUS ACESSÓRIOS (“JOYSTICKS”) e CARTUCHOS PARA TELEJOGOS, industrializados na Zona Franca de Manaus.

OS MINISTROS DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR e DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, no uso das atribuições que lhes confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, tendo em vista o disposto no § 6º do art. 7º do Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, e considerando o que consta no processo MDIC nº 52001.000613/2009-87, de 5 de junho de 2009, resolvem:

Art. 1º O Processo Produtivo Básico para os produtos TELEJOGOS E SEUS ACESSÓRIOS (“JOYSTICKS”) e CARTUCHOS PARA TELEJOGOS, industrializados na Zona Franca de Manaus, estabelecido pela Portaria Interministerial MDIC/MCTI nº 26, de 28 de janeiro de 2013, passa a ser o seguinte:

- I - fabricação da unidade magnética de disco rígido (HD), quando aplicável;
- II - encapsulamento da unidade de disco rígido, por meio da montagem mecânica e soldagem das tampas do gabinete que a envolve, quando aplicável;
- III - fabricação do gabinete do telejogo (tampa superior e inferior) a partir da injeção plástica, quando aplicável;
- IV - fabricação dos chicotes elétricos (feixe de fios com seus conectores) não sobreinjetados, a partir da trefilação e recozimento do fio de cobre;
- V - fabricação dos cabos de força para corrente alternada, mesmo sobreinjetados, fabricados a partir da trefilação e recozimento do fio de cobre;
- VI - fabricação dos circuitos impressos (placa nua) da placa mãe;
- VII - montagem e soldagem de todos os componentes nas placas do Módulo Wi-Fi, quando aplicável;
- VIII - montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso com componentes ou circuito integrado ou módulos que implementem a função de memória, do tipo DRAM ou NAND Flash, quando aplicável;
- IX - fabricação da unidade de armazenamento de dados, não volátil em meio semicondutor (SSD - Solid State Drive), quando aplicável;
- X - fabricação da fonte de alimentação (conversor CA/CC) ou gabinete metálico (chassi);

XI - montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso;

XII - montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e

XIII - integração das placas e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final, montadas de acordo com as etapas descritas nos incisos XI e XII.

§ 1º Todas as etapas descritas no caput deverão ser realizadas na Zona Franca de Manaus, exceto as etapas descritas nos incisos VI, VII e IX, que poderão ser realizadas em outras regiões do País.

§ 2º Desde que obedecido o Processo Produtivo Básico, as atividades ou operações inerentes às etapas de produção poderão ser realizadas por terceiros, exceto a etapa descrita no inciso XIII do caput, que não poderá ser objeto de terceirização.

§ 3º Ficam dispensadas, até 31 de dezembro de 2015, as etapas estabelecidas nos incisos I e II do caput deste artigo.

§ 4º O cumprimento das etapas previstas nos incisos III a X do caput deste artigo deverá observar o disposto no art. 4º.

Art. 2º Fica dispensado o cumprimento da etapa estabelecida no inciso XI do art. 1º até o limite de 18% (dezoito por cento) da quantidade total de placas montadas, a ser utilizada pela empresa na fabricação do produto, conforme produção no ano-calendário.

Parágrafo único. No caso de início de produção, a partir do segundo semestre do ano-calendário, o cumprimento do percentual a que se refere o caput poderá ser efetuado até 31 de dezembro do ano subsequente ao em que se verificar o início de produção.

Art. 3º Fica temporariamente dispensada a montagem dos seguintes módulos ou subconjuntos:

I - subconjunto mecanismo leitor de mídia para telejogos;

II - dispositivos de entrada de dados e/ou acionamento para controle de telejogos (joysticks e controle remoto), com ou sem sensor de captura de movimento e/ou som;

III - módulo de comunicação sem fio tecnologia Bluetooth;

IV - antena interna para rede de comunicação sem fio (rede wireless);

V - módulo de interface de comunicação sem fio (wireless) do console com o controle de telejogo (joystick);

VI - subconjuntos mecânicos constituídos de peças plásticas e/ou metálicas, com ou sem fiação elétrica, compostos de, até, 15 (quinze) componentes, exceto quando constituídos de gabinetes (tampa superior e inferior);

VII - módulo de comunicação sem fio (Wi-Fi) combinado com tecnologia Bluetooth, sob a forma de circuito integrado híbrido com encapsulamento tipo BGA (Ball Grid Array); e

VIII - placa de interface entre o painel frontal e a placa mãe (com função liga/desliga).

Parágrafo único. As dispensas a que se refere o caput para os dispositivos constantes dos incisos I e II aplicam-se, apenas, à fabricação do produto TELEJOGO.

Art. 4º Os seguintes subconjuntos, partes, peças e componentes deverão ser fabricados, conforme seus respectivos Processos Produtivos Básicos, e de acordo com o cronograma abaixo, no qual os percentuais são calculados sobre a base total de utilização dos respectivos componentes, no anocalendarário:

SUBCONJUNTOS, PARTES, PEÇAS E COMPONENTES	2013	2014	2015	2016	2017 em diante
I – Gabinete do telejogo (tampa superior e inferior) a partir da injeção plástica		50%	80%	80%	80%
II – Chicotes elétricos (feixe de fios com seus conectores) não sobreinjetados, fabricados a partir da trefilação e recozimento do fio de cobre.	50%	60%	80%	80%	80%
III – Cabos de força para corrente alternada, mesmo sobreinjetados, fabricados a partir da trefilação e recozimento do fio de cobre, observado o disposto no § 1º deste artigo.	50%	60%	80%	80%	80%
IV – Circuitos impressos (placa nua) da placa mãe.			20%	40%	50%
V – Módulo Wi-Fi		30%	40%	50%	50%
VI – Placa de circuito impresso com componentes ou circuito integrado ou módulos que implementem a função de memória, do tipo DRAM ou NAND Flash, quando aplicável.		30%	40%	50%	50%
VII – Unidade de armazenamento de dados, não volátil em meio semicondutor (SSD - Solid State Drive), quando aplicável.		30%	40%	50%	50%
VIII – Fonte de alimentação (conversor CA/CC) ou gabinete metálico (chassi)		50%	60%	80%	80%

1º Os cabos de força para corrente alternada aos quais se refere o inciso III do cronograma estabelecido no caput deste artigo deverão ser fabricados a partir da trefilação e recozimento do fio de cobre, quando produzidos em outras regiões do País, de acordo com o percentual mínimo de 90% (noventa por cento), em peso, tomando por base a quantidade total utilizada na produção, no ano calendário.

§ 2º Caso os percentuais estabelecidos neste artigo não sejam alcançados, a empresa ficará obrigada a cumprir a diferença residual em relação ao percentual mínimo estabelecido, em unidades produzidas, até 31 de dezembro do ano subsequente, sem prejuízo das obrigações correntes.

§ 3º A diferença residual a que se refere o § 2º não poderá exceder a 10% (dez por cento), tomando-se por base a produção do ano em que não for possível atingir o limite estabelecido.

§ 4º A fonte de alimentação (conversor CA/CC) a que se refere este artigo deverá ser fabricada a partir da montagem dos componentes na placa de circuito impresso e adição do cabo de força fabricado de acordo com o disposto no inciso III e no § 1º.

§ 5º Os percentuais de utilização de fontes de alimentação (conversores CA/CC) ou gabinetes metálicos (chassis), para fins de cumprimento do inciso VIII do cronograma estabelecido no caput deste artigo, podem ser contabilizados de forma isolada ou cumulativa.

§ 6º Excepcionalmente, o percentual de 50% estabelecido pelo inciso I do caput para a fabricação dos gabinetes do telejogo a partir da injeção plástica, com relação ao ano de 2014, poderá ultrapassar o percentual disposto no § 3º e ser compensado, em quantidade, pelas empresas, até o ano de 2017, sem prejuízo das obrigações correntes.

§ 7º Excepcionalmente, o percentual de 50% estabelecido pelo inciso II do caput para a fabricação de chicotes elétricos, com relação ao ano de 2013, poderá ser compensado, em quantidade, pelas empresas, até o ano de 2017, sem prejuízo das obrigações correntes.

§ 8º Excepcionalmente, o percentual de 50% estabelecido pelo inciso III do caput para a fabricação de cabos de força para corrente alternada, com relação ao ano de 2013, poderá ultrapassar o percentual disposto no § 3º e ser compensado, em quantidade, pelas empresas, até o ano de 2015, sem prejuízo das obrigações correntes.

§ 9º Excepcionalmente, o percentual de 30% estabelecido pelo inciso V do caput para a fabricação de módulos Wi-Fi do telejogo, com relação ao ano de 2014, poderá ultrapassar o percentual disposto no § 3º e ser compensado, em quantidade, pelas empresas, até o ano de 2017, sem prejuízo das obrigações correntes.

§ 10. Excepcionalmente, o percentual de 50% estabelecido pelo inciso VIII do caput para a fabricação da fonte de alimentação ou gabinete metálico, com relação ao ano de 2014, poderá ultrapassar o percentual disposto no § 3º e ser compensado, em quantidade, pelas empresas, até o ano de 2016, sem prejuízo das obrigações correntes.

Art. 5º No caso de empresa que não apresente produção, no ano seguinte, por motivo de encerramento de sua atividade fabril, encerramento de fabricação própria ou comprovação de término de contrato, em caso de fabricante atuando sob contrato de manufatura para terceiros, a empresa poderá repassar as obrigações de que tratam os §§ 5º a 10 do art. 4º à empresa sucessora do contrato, ou à empresa contratada para a manufatura do produto, desde que com a anuência desta.

Art. 6º Sempre que fatores técnicos ou econômicos, devidamente comprovados, assim o determinarem, a realização de qualquer etapa do Processo Produtivo Básico poderá ser suspensão temporariamente ou modificada, por meio de portaria conjunta dos Ministros de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Art. 8º Fica revogada a Portaria Interministerial MDIC/MCTI nº 26, de 28 de janeiro de 2013.

ARMANDO MONTEIRO

Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

ALDO REBELO

Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação